

Title (en)

Method for the manufacture of wood chipboards and medium density wood fibreboards.

Title (de)

Verfahren zur Herstellung von Holzspanplatten und mitteldichten Holzfaserverplatten.

Title (fr)

Procédé de fabrication de panneaux en particules de bois et de panneaux de moyenne densité en fibres de bois.

Publication

EP 0536795 A1 19930414 (DE)

Application

EP 92117336 A 19921009

Priority

DE 4133445 A 19911009

Abstract (en)

A process for the manufacture of wood chip boards and medium density wood fibre boards is described, in which the wood chips or wood fibres provided with binder are formed into chip or fibre mats and subsequently pressed at elevated temperature to form boards. The process is distinguished in that during the forming process at least one surface of the chip or fibre mat is provided with a layer of wood chips or wood fibres containing thermally non-curing binder and the chip or fibre mats thus formed are subsequently pressed.

Abstract (de)

Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Holzspanplatten und mitteldichten Holzfaserverplatten, bei dem mit Bindemittel versehene Holzspäne oder Holzfasern zu Span- oder Fasermatten geformt und anschließend bei erhöhter Temperatur zu Platten gepreßt werden, beschrieben. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß während des Verformungsvorganges mindestens eine Oberfläche der Span- bzw. Fasermatte mit einer Schicht aus thermisch nicht härthbares Bindemittel enthaltenden Holzspänen oder Holzfasern versehen wird, und die so geformten Span- oder Fasermatten anschließend gepreßt werden.

IPC 1-7

B27N 1/02; **B27N 3/10**

IPC 8 full level

B27N 1/02 (2006.01); **B27N 3/10** (2006.01)

CPC (source: EP)

B27N 1/0209 (2013.01); **B27N 3/10** (2013.01)

Citation (search report)

- [AD] DE 1176354 B 19640820 - MAX HIMMELHEBER DIPL ING
- [A] US 3308218 A 19670307 - WIEGAND DONALD E, et al
- [A] DE 1228798 B 19661117 - MAX HIMMELHEBER DIPL ING, et al

Cited by

US5955023A; EP0788866A3; EP0699510A3; EP0648807A1; US5532330A; EP2236313A1; US8632875B2; WO9835800A1; WO2010112125A1

Designated contracting state (EPC)

AT DE DK FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0536795 A1 19930414; **EP 0536795 B1 19950111**; AT E116896 T1 19950115; DE 4133445 A1 19930415; DE 4133445 C2 19950420; DE 59201191 D1 19950223; DK 0536795 T3 19950424

DOCDB simple family (application)

EP 92117336 A 19921009; AT 92117336 T 19921009; DE 4133445 A 19911009; DE 59201191 T 19921009; DK 92117336 T 19921009